

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

# 苏州昀冢电子科技股份有限公司

（昆山市周市镇宋家港路 269 号）



## 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年八月

## 一、本次募集资金使用计划

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 87,570.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于“芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目”“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”以及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 拟投资总额      | 拟用募集资金投资金额 |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | 芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目 | 23,000.00  | 19,080.00  |
| 2  | DPC 智能化产线技改扩建项目     | 18,000.00  | 17,050.00  |
| 3  | 片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目  | 35,000.00  | 25,440.00  |
| 4  | 补充流动资金及偿还银行贷款项目     | 26,000.00  | 26,000.00  |
| 合计 |                     | 102,000.00 | 87,570.00  |

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

### （一）芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目

#### 1、项目概述

本项目拟投资 23,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 19,080.00 万元，主要投资内容包括场地装修改造、设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项

目主要基于公司 CMI 业务发展需求，计划对当前 CMI 产线进行自动化、智能化、柔性化技术升级改造，以满足二代、三代及四代 CMI 产品生产要求并有效提升生产效率，从而提高生产水平与供货能力以满足业务需求。同时，通过扩大规模化效应提升产品成本优势，助力 OIS 防抖及潜望式镜头马达向中低端终端手机市场下沉，进一步扩大 CMI 系列产品的市场空间。

## **2、项目建设必要性**

### **(1) 提升公司生产能力，缓解产能瓶颈**

公司自成立以来，持续聚焦手机光学领域精密电子零部件的设计、制造和集成方案。CMI 系列产品作为公司自主研发的集成化产品，以高稳定性、高集成化、空间占用低等优势，持续切入高端手机镜头市场，近年来销售收入成持续增长态势，已成为公司主要营收来源之一。2024 年 CMI 产品收入较同期增长 24.56%，已接近公司整体营收的 40%。目前伴随着高集成化手机镜头需求的持续增长，公司 CMI 产线已基本处于满负荷生产，现有生产规模已经不能满足现有客户和新客户的需求，因此需要扩大 CMI 产品生产规模以满足客户采购及未来潜在市场需求，提高稳定交货能力，为公司未来发展奠定良好的基础。

本次项目拟通过购置先进生产设备及辅助设备，对产线进行整体改造更新。本项目将进一步提高公司产线智能化水平，有效提升生产效率，从而提高生产水平与供货能力以满足业务需求，进一步提高公司综合竞争实力，巩固及提升公司的市场地位，也为公司未来加大市场拓展力度奠定坚实的基础。

### **(2) 实现产线迭代更新，保障业务持续发展**

经过多年的持续研发更新，公司 CMI 产品已由最初平面的一代 CMI 产品逐步升级至二、三代立体产品以及目前高元件集成度的四代 HD-CMI 产品。在当前手机轻薄化需求以及多摄像头布局的发展态势下，相关马达配件趋向于小型化、高精度及高集成化。基于此，公司重点推进 CMI 二代、三代及四代产品在高端旗舰机的使用量，特别是潜望式及可变式光圈的市场应用，以进一步提高市场竞争力和盈利能力。由于 CMI 系列新产品生产工艺更为复杂，精细化程度更高，因此，其对于产线设备的要求也更高。

本项目拟通过对现有生产设备进行迭代更新，以满足二代、三代及四代产品生产要求。项目有利于精准响应持续增长的 CMI 系列产品市场需求，为公司 CMI

业务的稳健推进提供产能保障，同时新产线可以向下兼容前代产品的生产要求，可根据市场实际需求进行灵活调配，进一步提升资源利用率。

### **（3）持续加强规模效应，提高市场竞争力**

公司 CMI 产品主要应用于潜望式镜头马达模组与 OIS 防抖镜头马达模组，因产品本身在技术精度与性能上的高要求，当前主要配套高端手机镜头模组。从市场趋势看，OIS 防抖功能与潜望式镜头的市场渗透率正持续提升，且随着技术成熟与成本优化，二者有望突破高端机型边界，逐步向中低端手机市场下沉，为 CMI 产品带来更广阔的应用空间。

本项目计划通过对产线的升级改造，进一步提升 CMI 产品生产效率，依托于升级后的自动化制造及规模量产的成本优势，持续提高产品在高端手机镜头马达中的竞争力。同时，通过成本优势，助力 OIS 防抖及潜望式镜头马达向中低端手机市场下沉，从而进一步扩大公司 CMI 系列产品的市场空间。

## **3、项目可行性分析**

### **（1）广阔的下游市场空间为项目实施提供了市场基础**

公司 CMI 产品主要应用于手机潜望式摄像头、可变式光圈及光学防抖马达。根据 IDC 数据，2024 年全球智能手机出货量达 12.4 亿部，同比增长 6.4%。据 CAICT 中国信通院披露的数据显示，2024 年国内市场手机出货量 3.14 亿部，同比增长 8.7%。与此同时，Counterpoint 数据显示，高端智能手机（600 美元及以上）市场份额从 2020 年的 15% 上升至 2024 年的 25%，反映出手机市场持续高端化的趋势。上述产品在高端手机中应用占比更高，高端智能机市场份额的持续增长，为公司 CMI 产品提供了良好的市场增长空间。此外，随着技术成熟、成本优化以及手机行业竞争的持续加剧，潜望式摄像头、光学防抖马达等产品有望逐步向中低端手机市场下沉，相关产品市场需求有望持续提升，从而带动公司 CMI 产品需求持续增长。

### **（2）产品技术成本优势为公司带来了较强的竞争力**

CMI 系列产品作为公司自主研发的创新型集成化解决方案，通过融合冲压、成型、SMT、封装及电测等多重工艺以及金属插入成型等自研技术路线，实现对传统摄像头模组中分立器件的功能整合与结构集成，可大幅提升产品小型化程度与综合性能。CMI 系列产品自 2017 年成功上市并实现量产后，公司持续推进技

术迭代，过往每两年推出一代升级产品，当前第四代 HD-CMI 产品更引入陶瓷基板集成技术，集成度进一步提升，可大幅节省摄像头模组空间，更好适配潜望式镜头与大尺寸传感器等高端光学设计方案。同时，高集成度产品可以进一步简化下游马达厂组装流程，有效降低马达厂商工时成本。此外，通过多年的技术钻研，公司实现了全自动点锡贴片机、机器视觉检测装置等关键设备的自主研发，形成显著生产成本优势。

上述产品技术和成本优势为公司带来了较强的竞争力，为本项目的实施奠定了坚实基础。

**（3）优质的定制化服务与稳定的客户合作为项目产能消化提供坚实支撑**

公司自成立以来，始终聚焦手机光学领域精密电子零部件的研发与制造，凭借多年技术沉淀，对手机光学系统的结构设计、性能要求及工艺难点形成了深刻理解与技术积累。随着智能手机影像功能持续升级，潜望长焦、OIS 光学防抖等技术成为终端机型提升竞争力的关键。公司精准把握这一市场需求，依托核心技术能力，可快速响应客户定制化需求，为其提供涵盖潜望 CMI 底座、OIS 防抖 CMI 支架等核心马达部件从前期需求沟通、方案设计，到样品试制、批量生产及售后技术支持的全流程解决方案，确保产品与客户光学模组方案高度适配，助力客户提升终端机型影像表现。

凭借稳定的产品质量、高效的定制化响应能力及专业的技术服务，公司在行业内树立了良好口碑，成功与新思考、TDK、舜宇光学等产业链核心环节的头部企业建立长期深度合作关系，构建了稳定客户体系，产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等国内主流手机品牌的中高端机型。优质且稳定的客户基础，不仅为公司现有业务的持续增长提供保障，更能有效承接本项目新增产能，为产能消化提供坚实支撑。

**4、项目投资计划**

**（1）投资金额**

“芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目”计划投资总额为 23,000.00 万元，拟投入募集资金 19,080.00 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目     | 投资金额     | 占比    |
|----|--------|----------|-------|
| 1  | 场地装修改造 | 2,068.01 | 8.99% |

|    |         |           |         |
|----|---------|-----------|---------|
| 2  | 设备购置及安装 | 20,048.85 | 87.17%  |
| 3  | 铺底流动资金  | 883.14    | 3.84%   |
| 合计 |         | 23,000.00 | 100.00% |

## （2）建设周期

本项目计划建设周期为 2.5 年。

## 5、项目涉及报批事项情况

截至本报告出具日，本项目备案涉及的相关手续正在办理过程中。

## （二）DPC 智能化产线技改扩建项目

### 1、项目概述

本项目拟投资 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 17,050.00 万元，主要投资内容包括场地装修改造、设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项目计划对当前 DPC 业务产线进行自动化、智能化、柔性化技术升级改造，加快实现陶瓷热沉等产品规模化发展，持续扩大现有客户合作能力，并为新客户的开拓合作提供产能支撑，进一步释放公司业务增长潜力，实现公司电子陶瓷产品整体向高附加值产品的转换，推动业务新增长极。

### 2、项目建设必要性

#### （1）积极拓展公司业务布局，推动业务新增长极

近年来，公司在稳固消费电子主营业务优势的同时，积极布局电子陶瓷新赛道，旨在培育业务增长点、构建更具韧性与竞争力的业务生态。其中，DPC 陶瓷基板产品作为公司电子陶瓷领域的核心拓展方向之一，已于 2024 年取得关键性突破，产品切入激光热沉、T/R 组件等领域，业务呈现快速增长的积极态势。基于这一良好发展基础，公司需进一步加大该业务的投资力度，推动其成为新增长极，助力整体业务持续升级。

本项目计划通过购置蒸镀单体炉、激光打标切割设备、电镀镍钯金生产线等先进设备，以实现激光精密加工、黄光微影、电镀铜、减薄平坦化、表面处理、贵金属回收等生产工艺的自动化、智能化、柔性化技术升级改造，可加快实现陶瓷基板产品的规模化发展，推动业务新增长极。

#### （2）通过产线升级改造，实现向高附加值产品转换

在公司电子陶瓷业务发展初期，产品主要应用于 LED 陶瓷热沉基板领域。伴随着工业激光设备及 T/R 组件国产化趋势，公司积极跟进上述领域陶瓷热沉及管壳产品需求，致力于推动相关产品国产化进程，填补相关国产组件市场需求，向更高产品附加值领域迈进。经过多年的技术研发及市场开拓，目前公司产品已成功切入上述领域，相关产品出货量实现快速增长。

本项目计划通过对部分老旧产线进行淘汰及改造，满足工业激光设备等下游领域产品生产要求。项目有利于实现公司陶瓷基板产品整体向高附加值产品的转换，增强公司业务盈利水平，抓住市场机遇，保障公司未来的可持续发展。

### **（3）加强产品生产能力，匹配业务增长需求**

经过长期技术探索、多轮严格测试验证以及积极的客户开拓工作，公司大功率激光用热沉产品凭借高可靠性能与品质获得了客户的认可，不仅成功获取了稳定订单，产品市场需求更是实现快速攀升，单月出货量爬升至 300 万颗。但当前产能不足的核心瓶颈十分突出，现有产能仅能勉强满足少数合作客户的供应需求，供货能力的短缺不仅让公司错失了大量潜在客户的机会，更严重制约了新客户拓展的步伐，难以进一步扩大市场份额、释放业务增长潜力。

本项目计划对现有产线进行更新改造，通过引入更高效的自动化生产设备、优化生产流程、提升产线智能化管理水平等方式，突破因产能不足所导致的现有市场份额边界，持续扩大与现有客户合作能力，并为新客户的开拓提供产能支撑，进一步释放公司业务增长潜力。

## **3、项目可行性分析**

### **（1）项目所属行业受到国家政策支持**

公司 DPC 电子陶瓷产品属于国家战略性新兴产业重点发展方向，政策支持明确且持续加码。近年来，国家先后发布《“十四五”原材料工业发展规划》《电子信息制造业发展“十四五”规划》《制造业可靠性提升实施意见》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 版）》等重要文件，将电子陶瓷材料、高端热沉器件等纳入重点鼓励研发与产业化范畴，同时强调提升核心电子材料自主可控能力。

本项目旨在扩展公司 DPC 电子陶瓷产品生产规模，项目建设符合国家产业政策的指导方向，同时国家产业政策的鼓励支持为项目的顺利实施提供了重要支撑。

### **(2) 下游市场需求的快速增长为本项目的实施提供了良好的市场环境**

公司自主开发的热沉及管壳产品具备超高热导性、低膨胀系数、高绝缘性、耐高温、低热阻等特性，广泛应用于光纤激光器、半导体激光加工、超快激光器以及雷达及卫星等领域。上述产品应用领域近年来增长态势较好，且设备国产率持续提升。

根据《2025 中国激光产业发展报告》数据显示，2024 年，全球激光设备市场销售收入约为 218 亿美元，其中中国激光设备市场销售收入约 897 亿元，占比达到全球市场的 56.6%，保持稳步增长。从细分领域看，2024 年我国光纤激光器用特种光纤市场销售收入达 18.2 亿元，且光纤激光器国产化持续加速，市场份额占比达 86.2%，预计 2025 年将同比增长 13%；此外，在半导体、显示器制造和玻璃加工需求的推动下，2024 年我国超快激光器市场规模达到 45.5 亿元，同比增长 13.2%；在半导体激光加工领域，2024 年中国半导体激光加工装备市场规模超 37.5 亿元，同比增长 19.8%，预计 2025 年市场规模将突破 46 亿元。

T/R 组件主要应用于雷达及卫星领域。根据 AIoT 星图研究院数据，2023 年我国车载激光雷达出货量约为 71 万台，预计 2027 年出货量将达到 857 万台。在卫星领域，根据 BryceTech 数据显示，2024 年全球发射小卫星 2,790 颗，创历史新高，其中通信卫星比例在 2019 年后显著增加，最近几年占比均超过 70%；近 10 年小卫星发射次数由 2015 年的 33 次，快速增长至 2024 年的 199 次，预计未来卫星发射数量仍将持续攀升。

上述应用行业的持续向好为本项目的实施及产能消化提供了良好的市场环境。

### **(3) 优秀的产品性能及优质的客户资源为项目实施提供坚实保障**

公司聚焦高导热、低损耗、小型化陶瓷热沉产品的研发与生产，并于 2024 年取得关键技术进展，产品在尺寸精度、平整度、金属层膜厚均匀性、焊接功能区成分比例稳定性等方面均取得较好表现。与此同时，公司同步构建起覆盖产品设计开发、DPC 生产、表面处理、质量检测至贵金属回收的全流程自主可控体



系，既保障了产品质量稳定，也通过成本控制强化了竞争力，推动自主研发的激光热沉器件正式实现商业化量产，顺利完成从技术突破到产能落地的关键跨越。

在市场表现上，公司 DPC 陶瓷基板相关产品营收实现快速放量，凭借产品高性能优势，成功切入创鑫激光、华光光电子等行业头部企业供应链，且随着合作的持续深入，客户粘性持续增强，订单规模稳步提升，为业务长期发展打开广阔空间。公司优秀的产品性能及优质的客户资源为项目实施提供坚实保障。

#### 4、项目投资计划

##### （1）投资金额

“DPC 智能化产线技改扩建项目”计划投资总额为 18,000.00 万元，拟投入募集资金 17,050.00 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目      | 投资金额      | 占比      |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 场地装修改造  | 2,850.00  | 15.83%  |
| 2  | 设备购置及安装 | 14,719.00 | 81.77%  |
| 3  | 铺底流动资金  | 431.00    | 2.39%   |
| 合计 |         | 18,000.00 | 100.00% |

##### （2）建设周期

本项目计划建设周期为 2 年。

#### 5、项目涉及报批事项情况

截至本报告出具日，本项目备案涉及的相关手续正在办理过程中。

##### （三）片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目

##### 1、项目概述

本项目拟投资 35,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 25,440.00 万元，主要投资内容包括设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项目主要为进一步推动公司电子陶瓷业务中长期策略发展方向，计划通过新增生产线、优化生产布局、升级现有产能等方式，提升 MLCC 产品的整体产能供给能力，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，夯实业务新增长曲线底层支撑，助力公司加强 MLCC 业务的市场优势，推动业务规模与盈利能力持续提升。

## **2、项目建设必要性**

### **(1) 助力 MLCC 国产化，填补高容产品需求**

MLCC 作为电子电路中的核心被动元器件，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域，其供应链安全与自主可控对我国电子信息产业发展至关重要。当前，国内中低端 MLCC 产能已逐步实现自主供应，但在高容量、高可靠性等高端 MLCC 产品领域，仍存在一定进口依赖，尤其随着新能源汽车、5G 通信等下游行业快速发展，高容 MLCC 市场需求持续攀升，供需缺口成为制约产业链升级的关键环节。在此背景下，助力 MLCC 国产化替代、填补高容产品需求，既是突破供应链难题的重要举措，也是推动国内电子元器件产业向高端化升级的核心方向。

本项目计划通过对现有产线进行技术升级改造，优化生产工艺，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，帮助满足国内下游终端企业对高容 MLCC 的迫切需求，降低产业链采购成本与供应链风险，完善国内 MLCC 产业生态，提升我国在全球电子元器件领域的核心竞争力，为我国电子信息产业高质量发展筑牢基础。

### **(2) 推动公司中长期发展战略落地，夯实业务新增长曲线底层支撑**

MLCC 作为全球用量最大、发展最快的片式电子元器件之一，凭借千亿级市场规模、下游需求高增长、应用场景广覆盖及显著的国产替代空间，成为电子元器件产业中极具战略价值的赛道。基于此，公司在稳固消费电子主营业务发展、积极开拓汽车电子业务的基础上，明确将 MLCC 纳入中长期策略发展方向，将其作为夯实业务新增长曲线的关键抓手，持续加大研发投入与生产布局力度。公司目前已实现 0402、0603 等多尺寸系列产品的研发及生产，可满足下游多领域基础应用需求。同时正加速更高规格产品的核心技术攻关与市场拓展，进一步完善产品矩阵，逐步覆盖更高价值的应用场景，为公司构建长期、稳定的新增长曲线筑牢底层支撑，推动中长期发展战略稳步落地。

为进一步推进 MLCC 业务规模化发展、加速中长期战略落地，本项目计划通过对现有产线进行技术升级改造，重点围绕生产效率提升、产品良率优化、高端产能释放三大核心目标展开。通过本次改造，既能快速提升公司 MLCC 产能

规模与质量稳定性，更能为后续更高规格产品的研发生产提供硬件支撑，夯实业务新增长曲线底层基础，推动公司中长期战略稳步落地。

### **（3）扩大产能供给能力，推动业务规模与盈利能力持续提升**

当前公司 MLCC 业务呈现显著增长态势，产品市场需求持续攀升，已进入增量发展阶段。从实际经营情况来看，自 2025 年起，MLCC 产品产销衔接高效，已基本实现“产出即销售”的良好局面，生产线长期保持满负荷运行状态，现有产能已难以进一步承接新增订单，产能瓶颈逐渐凸显，成为制约业务持续扩张的关键因素。

为突破当前产能限制、把握市场增长机遇，保障公司 MLCC 业务稳步发展，本项目计划进一步扩大 MLCC 产品生产规模。通过新增生产线、优化生产布局、升级现有产能等方式，提升 MLCC 产品的整体产能供给能力。本项目的实施不仅可有效缓解当前产能压力，更能为公司承接更多市场订单、应对下游客户持续增长的采购需求提供坚实支撑，助力公司加强 MLCC 业务的市场优势，推动业务规模与盈利能力持续提升。

## **3、项目可行性分析**

### **（1）项目建设符合国家相关政策导向**

MLCC 作为电子信息产业关键基础元件，深度受益于国家战略政策支持。2021 年工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》将 MLCC 列入重点支持范围，旨在加快 MLCC 等基础元器件发展，提升产业链现代化水平，保障产业链供应链安全；2023 年 1 月工信部等 6 部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺；2023 年 6 月工信部等五部门发布的《制造业可靠性提升实施意见》提出聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平；2023 年 8 月工信部、财政部《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》提出梳理基础电子元器件等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施，为 MLCC 行业发展提供了标准指引。2023 年 12 月，国家发改委发布的《产

业结构调整指导目录（2024 年本）》提出积极推动电子元器件生产专用材料发展，包括电子陶瓷材料等 MLCC 相关材料，为 MLCC 产业上游材料供应的发展。

本项目旨在扩展公司 MLCC 高容产品生产规模，项目建设符合国家产业政策的指导方向，同时国家产业政策的鼓励支持为项目的顺利实施提供了重要支撑。

### **（2）持续释放的市场需求是项目产能消化的保障**

随着全球整体经济恢复增长，手机、笔记本电脑在内的消费电子产品订单需求开始回升，叠加通信设备、汽车电子、工业控制等领域市场需求增加，全球 MLCC 市场重回增长态势。根据赛迪顾问数据显示，2024 年全球 MLCC 市场规模达到 231.3 亿美元，同比增长 7.5%，穿越市场周期低谷。其中我国 MLCC 市场在庞大的需求下，也实现触底反弹，市场规模达 544.4 亿元，同比增长 11.8%，相比全球增速高 4.3 个百分点。

从细分市场来看，随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化方向发展，单车 MLCC 用量显著增加，汽车电子领域成为全球 MLCC 市场规模增长的主要驱动力，汽车电子 MLCC 市场规模同比增长 11.9%。此外，通信设备、工控设备领域受经济复苏影响 MLCC 市场规模也实现正向增长。整体来看，随着 5G 通信、汽车电子、人工智能等领域的技术突破与市场扩张，MLCC 的市场需求将迎来爆发式增长，预计从 2024 年的 231.3 亿美元增长到 2027 年的 334.1 亿美元，年复合增长率达 13.0%。持续释放的市场需求为项目的产能消化提供了良好保障。

### **（3）公司实力雄厚的核心团队与技术优势有效保障本项目的顺利实施**

公司自开展电子陶瓷业务以来，始终聚焦于产品技术开发和拓展工作，组建了一支专业知识匹配、技术经验丰富的高素质复合型人才团队，公司 MLCC 业务核心团队实力雄厚，核心成员均来自头部 MLCC 企业，拥有丰富的行业经验，能深度洞察行业技术难点与市场需求。自 2021 年团队组建以来，已逐步攻克材料配方、精密印刷、叠层烧结等核心技术，同步搭建起完善的工艺流程与全维度品质管理体系，为业务发展奠定坚实基础。

在技术优势方面，公司自主研发材料与配方，有效降低对进口材料的依赖。同时，依托公司自动化设备技术支持，已完成部分生产设备的自主开发，显著提

升产线智能化水平，推动产品良率持续改善。2024 年，公司产品成功获得 IATF16949:2016 认证，这一成果标志着其进入汽车电子供应链的技术能力已获国际认可，为车规级 MLCC 量产扫清关键障碍。

公司核心团队凭借深厚的行业经验与技术积累，为项目扩产提供了可靠的质量保障。而全流程自主技术体系与通过国际认证的质量管理体系，也进一步确保了产能提升过程中产品的一致性、可靠性以及市场拓展性，为业务规模化发展保驾护航。

**4、项目投资计划**

**(1) 投资金额**

“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”计划投资总额为 35,000.00 万元，拟投入募集资金 25,440.00 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目      | 投资金额      | 占比      |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 设备购置及安装 | 34,538.00 | 98.68%  |
| 2  | 铺底流动资金  | 462.00    | 1.32%   |
| 合计 |         | 35,000.00 | 100.00% |

**(2) 建设周期**

本项目计划建设周期为 2 年。

**5、项目涉及报批事项情况**

截至本报告出具日，本项目已取得备案文件及环评批复。

**(四) 补充流动资金及偿还银行贷款项目**

**1、项目概述**

公司基于业务快速发展对流动资金的需求，拟使用本次募集资金中 26,000.00 万元补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司经营资金需求，优化资产结构，降低财务费用，增强公司的抗风险能力。

**2、项目建设必要性**

**(1) 公司业务快速扩张，对流动资金需求增加**

近年来，公司除了持续发展消费电子业务外，还在汽车电子和电子陶瓷领域大力投入。随着公司业务的快速扩张，公司对流动资金的需求也随之增加。本次

募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，能够缓解公司因业务快速扩张带来的资金短缺问题，为公司人才队伍建设、研发能力及运营能力提供持续性的支持，提高公司综合竞争力，巩固公司在行业内的领先地位。

## **（2）优化资本结构，提高抗风险能力**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 89.73%，处于较高水平。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于优化公司的资本结构，降低资产负债率，提高公司抗风险的能力，促进公司长期稳定的发展。

## **3、项目可行性分析**

### **（1）本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件**

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

### **（2）公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系**

公司已按照上市公司治理标准建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

同时，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用，防范募集资金使用风险。

## **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

公司本次募集资金主要用于“芯片插入集成(CMI)元件技改扩建项目”“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，是公司为顺应公司战略发展而做出的重要布局。芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目是为在维持主营业务市场需求的同时，通过对产线进行技改升级，持续扩大产品生产规模，缓解生产压力，并满足公司高规格产品的生产要素，进一步推动主营业务增长。DPC 智能化产线技改扩建项目及片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目则是基于公司中长期发展

战略以及当前公司电子陶瓷产品营收实现快速放量的态势下，通过提升相关产品的整体产能供给能力，进一步释放公司业务增长潜力，推动公司业务新增长极。补充流动资金及偿还银行贷款项目则是通过注入流动性资金与降低债务负担，缓解公司资金周转压力，助力业务正向发展。

本次发行能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的技术实力和服务能力，从而进一步提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，财务状况将有所改善，抗风险能力将进一步提升。但由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，可能在短期内难以实现预期效益，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目具有良好的市场前景、经济效益和社会效益，未来随着项目的运营实施，公司的经营规模和盈利水平将进一步增强，财务状况得到进一步改善，最终将会推动公司的业务规模和盈利能力进一步提升。

## **四、募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力和服务能力，巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金是必要的、可行的。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2025年8月29日